

IEEE International 3D Systems  
Integration Conference 2024

(3DIC 2024)

出展マニュアル v4

IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024

## 1. 3DIC開催趣旨

IEEE 3DICは、3次元LSIに関する日本で初めての国際会議として、超先端電子技術開発機構 (ASET)の主催で2007年3月に開催された「3D-SIC2007」から続くもので、2009年より日欧米を毎年持ち回りで開催するIEEEの名を冠した国際会議になりました。回を重ねるごとに内容が充実するとともにその規模が拡大し、名実ともに3D-IC/チップレット・システム集積に関する最も著名な国際会議となっています。今回は、13回目の開催であり、世界中の主要な3D-IC/チップレット・システム集積研究者を招待するとともに、国内外から一般口頭講演とポスター発表を募り、参加者全員が実質的な議論ができるように会議を構成しています。3D-IC/チップレット・システム集積の研究には、半導体プロセス、デバイス技術からパッケージ技術、設計、システムアーキテクチャにまで跨がる幅広い知識が必要となるため、専門領域を超えた議論ができる知識技術融合型の本会議を継続的に開催するとともに、若手研究者の積極的な参加を促し、当該分野を代表する国際会議の一つに発展させることを目指しております。

## 2. 企業展示概要

- (1) 名称 IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024 (3DIC2024)
- (2) 組織委員長 田中 徹 (東北大学 大学院医工学研究科 教授)
- (3) 会期 2024年9月25日(水)～9月27日(金)  
会議：2024年9月25日(水)～9月27日(金)  
展示会：2024年9月26日(木)～9月27日(金)
- (4) 会場 9月26日(木)と9月27日(金) 仙台国際ホテル  
電話 022-268-1111  
住所 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1  
注：9月25日(水)の会議は、ホテルメトロポリタン仙台で開催されます。  
アクセス：  
<https://www.tobu-skx.co.jp/hotel/access/>  
JR仙台駅より徒歩5分  
地下鉄仙台駅南2出口より徒歩4分
- (5) 日程  
搬入・設置 2024年9月25日(水) 20:00～21:00  
主催者工事 18:00～20:00、  
出展者設営 9月25日(水) 20:00～21:00 or 9月26日(木) 08:45～10:15  
展示時間 2024年9月26日(木) 10:20～18:30  
2024年9月27日(金) 9:00～16:00  
搬出・撤去 2024年9月27日(金) 16:00～17:00
- (5) 参加人数 約200名予定

(6) スケジュール (3DIC2019の例を参考に載せてあります。追って更新情報をご連絡致します。)

	8:30	8:45	9:00	10:20	10:35	11:30	12:05	13:20	13:30	14:40	14:55	15:00	15:15	16:00	16:20	16:40	17:00	17:50	18:00	18:30	19:00	20:00	20:30	21:00
10月8日	#NAME?																							
宮城野区文化センター シアターホール	主催者工事設置 (18:00-20:00)																							
ホテルメトロポリタン仙台	出展者設置 (20:00-21:00)																							
10月9日	受付開始 8:45-	講演セッション (9:00-10:20)	休憩	講演セッション (10:35-12:05)	昼食					講演セッション (14:55-16:05)	休憩 (16:05-16:20)	講演セッション (16:20-17:50)							パネット (18:00-20:00)					
宮城野区文化センター シアターホール			休憩/ 展示参 観 (10:20- 10:35)		昼食/ 展示参 観 (12:05-13:30)	ポスターセッション/ 展示参 観 (13:30-15:00)													休憩/ 展示参 観 (18:00- 18:30)	パネルセッション (18:30-20:30)				
出展関連	出展者設置 (8:45-10:20)		展示時間 (10:30-18:30)																					
10月10日	受付開始 8:45-	講演セッション (9:00-10:20)	休憩	講演セッション (10:35-12:05)	昼食	講演セッション (13:30-15:00)	休憩 (15:00-15:15)	講演セッション (15:15-16:25)	授賞式・閉会式 (16:25-17:00)															
宮城野区文化センター シアターホール			休憩/ 展示参 観 (10:20- 10:35)		昼食/ 展示参 観 (12:05-13:30)		休憩/ ポスター セッション/ 展示参 観 (15:00-15:15)			出展者による撤去 (16:00-17:00)	主催者による 撤去 (17:00-18:00)													
出展関連	出展者設置 (8:45-9:00)	展示時間(9:00-16:00)										撤去												

2. 企業展示について

(1) 出展対象 ・装置、材料、加工技術、解析技術、受託加工他

(2) 出展料金

■ 企業展示

種類	単位	小間サイズ	場所	出展料金 (税別)
基礎小間	1 小間	W1, 800mm×D900mm ×H2, 100mm	1F 展示会場	150,000 円

(3) 募集小間数 30小間

(4) 展示小間割の決定 事務局にて決定いたします。

(5) 出展物  
出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。

(6) 出展料のお支払いについて  
お申込み締め切り後、事務局より請求書をお送りいたしますので、期日までに指定口座（請求書に記載）にお振込み下さい。

(7) 出展受付のメ切・キャンセルについて  
出展受付のメ切は2024年7月26日（金）とさせていただきます。8月24日（土）以降のキャンセルについては、一切お受けできません。  
キャンセルの場合は 100%キャンセル料が発生いたしますので、予めご了承下さい。

(8) 電気  
出展企業の希望により、有償で電気（交流単相二線式 100V50Hz）を開閉器にて小間まで供給します。それ以外の特種電源に関しては別途ご相談下さい。

(9) 禁止事項  
装飾物、展示物の高さは、2.1m に制限します。ただし、やむを得ず超える場合は運営事務局

の承認を必要とします。また、水、プロパンガス、圧縮空気の使用、床面および壁面への直接工作（ゴムテープ、アンカー等）、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは原則的に禁止します。但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。

- (10) 外国出展物  
展示場は、保税展示場にはしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、またはATAカルネの制度をご利用下さい。詳細は、運営事務局にお問い合わせ下さい。
- (11) 出展企業へのご案内 開催の1ヶ月前までに小間割、搬入、装飾、管理等について詳細をご連絡いたします。  
什器・照明器具等のリースにつきましてもこの時に併せてご案内いたします。
- (12) 会場の管理  
会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的被害の発生については責任を負いません。
- (13) 会期・開場時間・開催場所の変更  
やむを得ない事情により会期・開場時間・開催場所を変更する場合があります。この変更を理由として出展申込を取り消すことは出来ません。  
また、これによって生じた損害は補償しません。
- (14) 本会議への参加資格について  
出展企業に対しては1小間あたり2名まで講演会場へ入って聴講が可能です。なお、展示会場内への入場制限はございません。出展企業向け参加者記入フォームにご記入の上、事務局に8月23日までにご返送ください。

なお、無料枠2名は、9月25日(水)にホテルメトロポリタン仙台で開催される講演セッションの聴講も可能ですが、同日のバンケットへの参加には別料金が必要です。

なお、仙台国際ホテル周辺に飲食店はございますので、お弁当は準備いたしません。

- (15) プログラム・抄録集について  
出展企業には、IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024 のプログラム・抄録集を1部無償で提供いたします。
- (16) 展示物の送付先  
宅急便を展示会場に直接発送する場合には、届け先欄に必ず会社名を明記してください。  
9月25日(水)会場必着にてお送りください。  
お荷物の受取にお立合いいただき必要はありません。  
届いた荷物は、事務局にて、出展ブース前に置いておきます。

仙台国際ホテル 9/26-27 3DIC2024 出展企業名〇〇〇〇 TEL: 022-268-1111 住所 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
---

### 3. 小間仕様

基礎小間（パッケージブース）：1 小間＝間口 1,800mm×奥行 450mm×高さ 700mm

・展示台 1 台（W1,800mm×D450mm×H700mm）

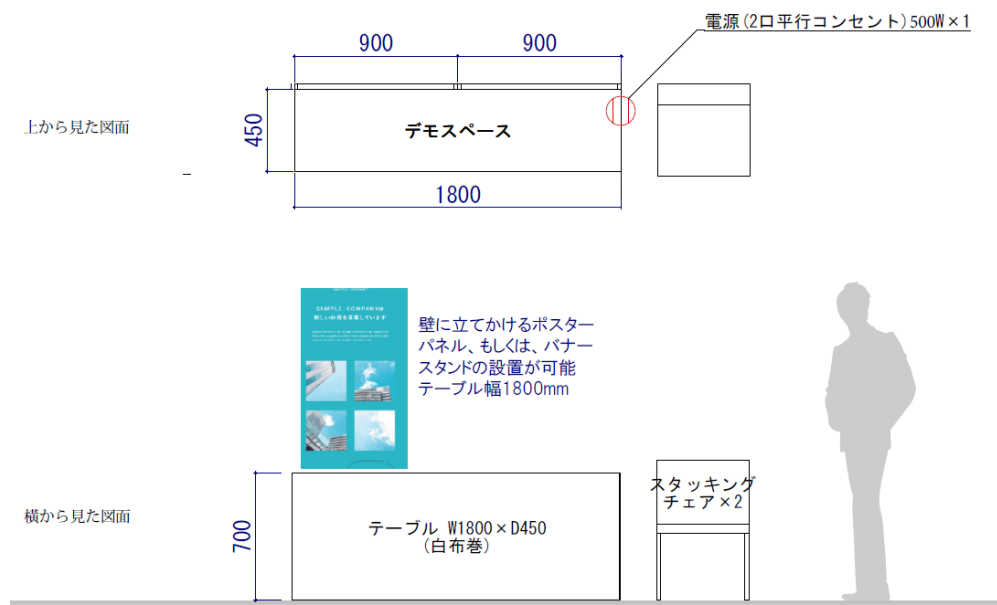
白布付き（但し商品の上にかけるクロスはご持参下さい）

・バックパネル無し（希望があれば有償ですがご用意できます）

・少し斜めにし壁に立てかけるイメージ（クロス貼り、画鋏留め、両面テープ全て不可）

・社名版（角ゴシック・黒文字）

・椅子（2 脚）



以上のものは運営事務局で設置いたします。

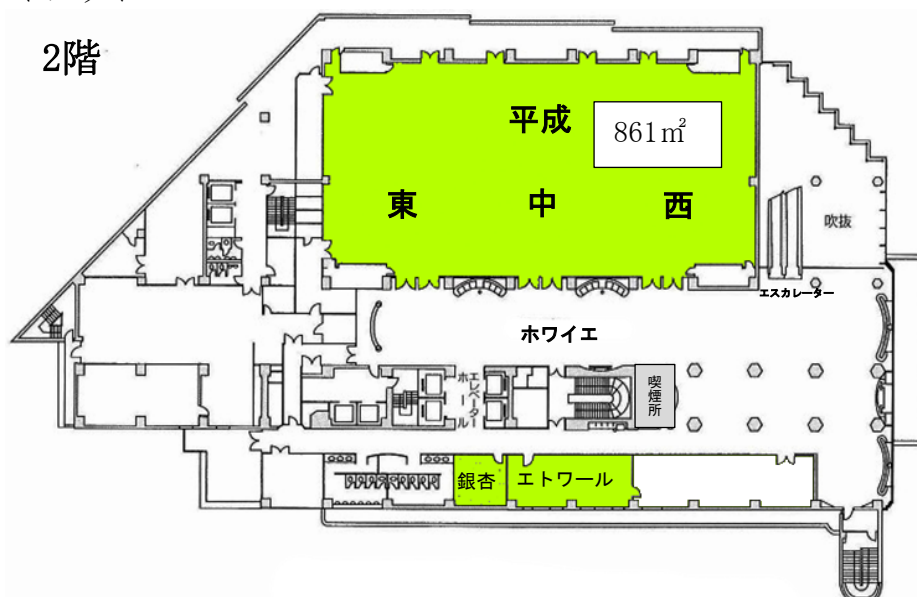
上記以外の小間内装飾は、出展企業が行って下さい。バナーロールのようなものを使って頂いても結構でし、通行の障害にならなければテーブル前にディスプレイを置くなど可能です。

電源等をご希望の方は、事務局にご連絡ください。別途費用にてお承りいたします。

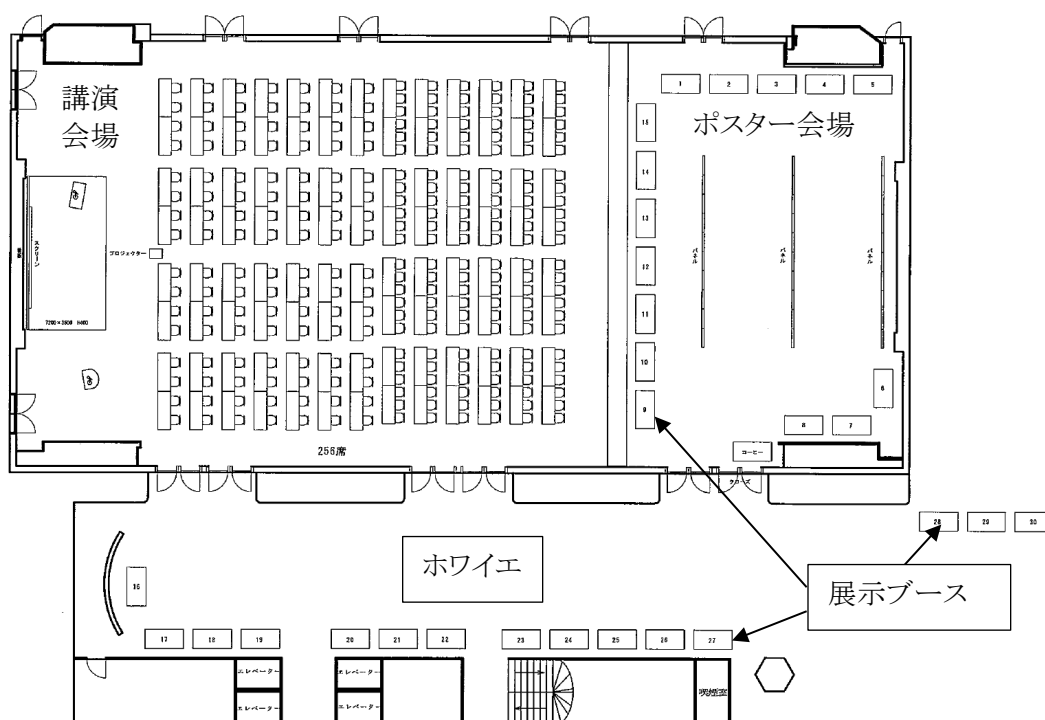
9月25日（水）午後8時～9時の出展者設営につきましては、展示会場前に出展者受付を設営いたします。セキュリティの関係で、事前にご登録された方にご入場頂けます。なお、当日、受付にお越しの場合は、ご出展者様に確認を申し上げる場合がありますので、ご了承ください。

#### 4. フロアレイアウト

2階



平成の間 (全)



企業展示の場所は、上記、2階平成の間の右1/3 (西) とホワイエでございます。企業展示、ポスターセッション、コーヒーサービスと同じ会場です。ブース位置は8月下旬にご案内します。

問い合わせ・お申込みについて

出展に関するお問い合わせ・お申込みは下記にお願いいたします。

IEEE International 3D Systems Integration Conference 2024事務局

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 メソニック 39MT ビル 4F

株式会社セミコンダクタポータル

【 TEL 】 03-5733-4971, 【 FAX 】 03-5733-4973

【 E-mail 】 [3dic\\_2024@semiconportal.com](mailto:3dic_2024@semiconportal.com)

または [naoko.tani@semiconportal.com](mailto:naoko.tani@semiconportal.com)